

# 5G／ミリ波帯の高周波パッケージ／実装技術

## Assembling and Packaging Technologies for 5G and Millimeter wave band

杉本 好正<sup>†</sup>

Yoshimasa Sugimoto<sup>†</sup>

<sup>†</sup>京セラ株式会社 半導体部品セラミック材料開発部

### 概要

次世代移動体無線通信の5Gでは、従来から利用されてきた数GHzの周波数波帯に加え、より大容量のデータ送受信に対応可能な30GHz帯、60GHz帯といったミリ波帯の利用が検討されている。伝送信号の高周波化により、パッケージや実装にも高周波への対応が要求されている。本稿では、5G／ミリ波帯に必要な高周波対応のセラミックパッケージ／実装技術について述べる。

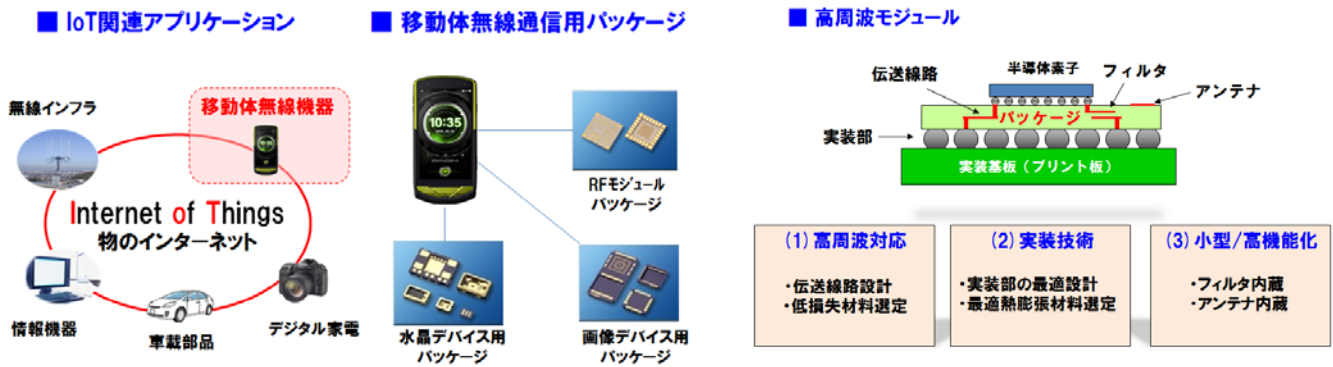


図1 IoT 関連アプリケーションとパッケージ製品

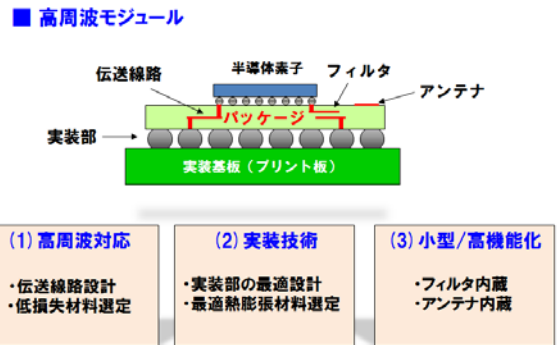


図2 5G に向けたパッケージと実装の課題

### Abstract

To adopt to a larger data transmission, an application of millimeter-waves (30GHz and 60GHz bands) is taken in consideration; in addition to conventional a few-Giga-Hertz frequency band for 5th generation wireless telecommunication. To meet with such trend, assembling and packaging technologies for high frequencies are also in demand. In this paper, we will explain about assembling and packaging technologies for 5G and millimeter wave band.